

#### 【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by an imbalance of thermal stress imposed during the cooling of solder in component mounting (Component mounting process)

Note: As this phenomenon is not progressive, this is not considered as a defect now.

### 10-1-4 複数引け巣／多点的收缩孔／ Multiple shrinkage cavities

【特徴】 はんだフィレットの中に複数の巣が認められる欠陥

【特徴】 焊脚中有多个气孔的缺陷。

【Characteristics】 Multiple small cavities exist in a solder fillet.

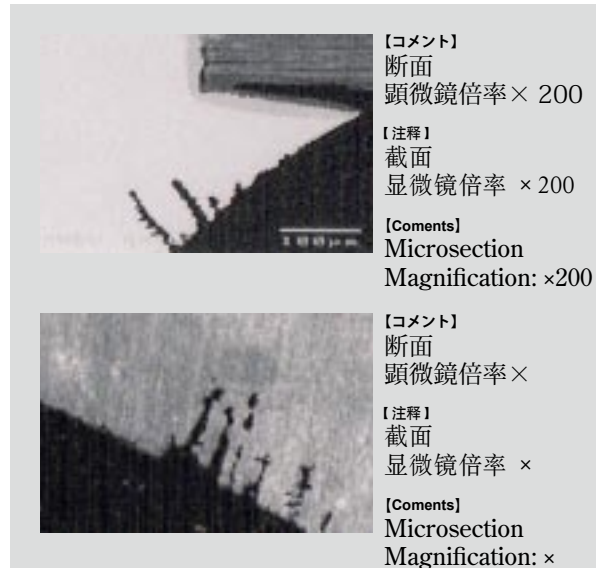
【起因・判断ポイント・発生工程】 電子部品実装はんだが冷却する際の熱ストレスのアンバランスにより出来たもの（電子部品実装工程）※ただしこの現象は、進行性がないため現在のところ不良としては扱われていない。

【原因、判断要点、発生工序】 元件封装的焊料在冷却时，热应力不平衡而引起的（元件封装工序）※这种现象没有重复性，现在不作为不良处理。

#### 【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by an imbalance of thermal stress imposed during the cooling of solder in component mounting (Component mounting process)

Note: As this phenomenon is not progressive, this is not considered as a defect now.



### 10-1-5 リード線界面剥離／引脚的界面剥离／ Separation of solder from component lead

【特徴】 部品リード線とはんだの界面が剥離している状態の欠陥

【特徴】 元件的引脚从焊接界面分离的缺陷。

【Characteristics】 A solder fillet is separated from the component lead at the solder joint interface.

【起因・判断ポイント・発生工程】 電子部品実装はんだが冷却する際の熱ストレスのアンバランスにより出来たもの（電子部品実装工程）

